

보 도 해 명 자 료

(’17.10.10)

수신 : 산업통상자원부 등록기자

제목 : “반도체 패키징 해외공장선 못할수도...”(10.10, 매일경제 인터넷판)

1. 기사내용

- “반도체 패키징, 해외공장선 못할수도...” 제하 기사에서 산업부는 16나노 이하 D램 패키징과 64단 이상 낸드플래시 패키징 기술을 국가핵심기술로 지정하는 것을 검토

2. 동 기사에 대한 산업부 입장

- 메모리 반도체 조립·검사기술(패키징)은 산업기술보호법이 제정된 2007년부터 국가핵심기술로 지정
 - 산업부는 매년 수요조사 등을 통해 업계의 의견을 반영하여 핵심 기술 범위를 시장상황에 맞춰 개정
 - D램은 2016년 11월, 40나노 → 30나노이하 조립·검사기술(패키징)로 관련 국가핵심기술을 완화
 - 낸드플래시는 2015년 9월, 50나노 → 30나노이하 조립·검사기술(패키징)로 국가핵심기술을 개정
 - 동 보도의 16나노이하 D램, 64단이상(11나노) 낸드는 이미 국가핵심기술로 지정되어 있어, 신규지정여부는 검토하지 않음
- ※ 문의 : 산업통상자원부 전자부품과 박영삼 과 장 (044-203-4270)
전자부품과 이정남 사무관 (044-203-4273)